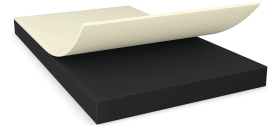




tesa[®] XPU 58701

Thông tin Sản phẩm



Băng keo HAF polyurethane màu đen dày 25µm có liên kết dạng X và kích hoạt bằng nhiệt

Product Description

tesa[®] XPU 58701 là băng keo kích hoạt dính bằng nhiệt, có độ dính cao và độ đàn hồi tốt hơn theo thời gian. Loại băng keo hai mặt đen này có lớp vỏ giấy phủ PE và không có lớp nền. tesa[®] XPU 58701 không chứa halogen theo tiêu chuẩn IEC 61249-2-21 và tuân thủ tiêu chuẩn RoHS hiện hành.

Băng keo không dính ở nhiệt độ thông thường, nó được kích hoạt bởi nhiệt độ cao và áp lực trong quá trình lắp ráp.

Đặc tính kỹ thuật:

- Độ tin cậy và hiệu suất liên kết cực cao, ngay cả trên những khoảng trống thiết kế mỏng
- Khả năng chống va đập tuyệt vời
- Chống nước
- Màu đen

Ứng dụng

tesa[®] XPU 58701 được đặc biệt khuyên dùng để liên kết cấu trúc của các chất nền khác nhau bên trong các thiết bị điện tử:

- Liên kết nhựa
- Liên kết kim loại
- Liên kết các linh kiện điện tử

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Cấu tạo sản phẩm

- | | | | |
|----------------------------|---------------|------------|----------------------------|
| • Vật liệu lớp lót (liner) | giấy tráng PE | • Loại keo | crosslinkable polyurethane |
| • Backing material | không | • Độ dày | 25 µm |

Thuộc tính / Giá trị hiệu suất

- Độ kết dính (lực đẩy) 1.5 N/mm²

Thông tin thêm

Thông tin kỹ thuật:

tesa[®] XPU 58701 không phải băng keo tự dính mà khả năng kết dính được kích hoạt bởi nhiệt độ và áp lực trong một khoảng thời gian nhất định. Các thông số sau đây có thể dùng để tham khảo:

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=58701>



tesa[®] XPU 58701

Thông tin Sản phẩm

Thông tin thêm

Cán sơ bộ

Trong quá trình này, băng keo được cán lên lên linh kiện thứ nhất.

Điều kiện:

- Nhiệt độ¹ 55-65 °C
- Lực ép² 3 bar
- Thời gian 5 – 20 s

Thời gian ngắn tiếp xúc với nhiệt độ dòng liên kết 65 ° C trong quá trình cán sơ bộ không ảnh hưởng đến khả năng liên kết cuối cùng.

Kết dính

Bóc lớp vỏ khỏi băng keo sau bước cán sơ bộ.

Định vị thành phần thứ hai. Áp dụng nhiệt độ và áp suất để thời gian liên kết đạt đủ độ bền liên kết.

PC/PC:

Điều kiện:

- Nhiệt độ¹ 80 – 140 °C
- Lực ép² 5 bar
- Thời gian 10 – 120 s

AL/PC:

Điều kiện:

- Nhiệt độ¹ 110 – 190 °C
- Lực ép² 5 bar
- Thời gian 20 – 120 s

Thời gian chu kỳ ngắn có thể đạt được ở nhiệt độ dòng liên kết cao. Để kích hoạt ở nhiệt độ thấp, hãy tăng thời gian ép nhiệt. Để đạt được độ bền liên kết tối đa, bề mặt phải sạch và khô. Chờ ít nhất 1-2 giờ sau khi kết dính trước khi kiểm tra hiệu suất. Độ bền liên kết cuối cùng sẽ đạt được sau 24 giờ.

Các giá trị độ bền liên kết thu được trong điều kiện phòng thí nghiệm tiêu chuẩn.

PC / PC: điều kiện liên kết : nhiệt độ = 110 ° C (120 ° C đờ gá); áp suất = 5 bar; time = 60 giây.

Bảo quản: tesa[®] khuyên bạn nên bảo quản trong bao bì gốc ở điều kiện khô ráo và thoáng mát. Nhiệt độ tại bước 'Cán sơ bộ' và 'Liên kết' liên quan đến dữ liệu được đo trong đường liên kết. Áp suất tại bước 'cán sơ bộ' và 'liên kết' đề cập đến lực được truyền trực tiếp từ bề mặt đồ gá đến vùng liên kết.

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=58701>



tesa[®] XPU 58701

Thông tin Sản phẩm

Disclaimer

sản phẩm của tesa@ được cải tiến chất lượng theo yêu cầu và được quản lý chặt chẽ từ giai đoạn sản xuất. Tất cả các thông tin và tư vấn sản phẩm được cung cấp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức của chúng tôi. Tuy nhiên, tesa SE không thể đảm bảo hay quy định một cách rõ ràng hoặc ngụ ý, có bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích sử dụng cụ thể. Do đó, người tiêu dùng nên nhận định sản phẩm tesa đang sử dụng có phù hợp cho mục đích sử dụng mà khách hàng đang nhắm tới hay không, có phù hợp với phương pháp mà khách hàng sử dụng hay không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi rất vui lòng để tư vấn cho quý khách

để biết thêm thông tin mới nhất của sản phẩm xin vui lòng cập nhật vào <http://l.tesa.com/?ip=58701>